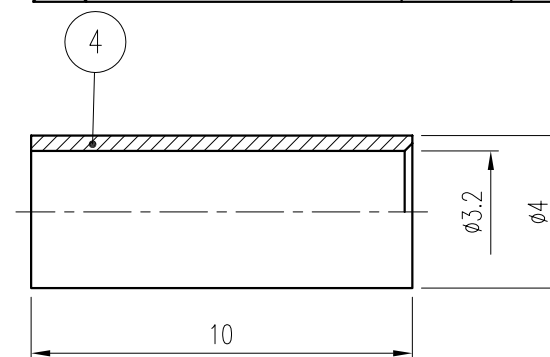


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	메이팅 부분 변경 및 도금 두께변경	손윤호	김준범	2005. 1. 12.
2	(설번)연구2005-135 COVER 형태변경 (CHP'G 발생의 개선 사항으로 내부 턱 없앴.)	김인철	유일환	2005. 5. 24.
3	(설번)연구2005-151 INSULATOR COVER 삽입	김인철	유일환	2005. 6. 10.
4	도면표준화 작업	최총락	유일환	2005. 6. 15.
5	업체요구(설번No.연구2005-211) (널링 부위 간격 표준화, ROUND 추가)	김은희	최총락	2005. 09. 05.
6	(설번No.연구2007-007) 조립성 향상		윤상진	2007. 1. 11.



- Gold Plate : 0.4 μ m 이상 (BODY,CONTACT,JACK,COVER)

2 63 1 4321 21	7	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DCO00020-5/1 (L3023)	
	6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00922-N/1 (H3143)	
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00298-N/2 (H3137)	
	4	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00034-5/2	
	3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate (0.4μm이상)	DCT00393-5/1 (E3154)	
	2	BODY(B)	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DBD00455-5/1 (D3157B)	
	1	BODY(A)	1	MBsBD	Nickel Plate (5μm이상)	DBD00480-5/1 (D3157A)	
매체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2004. 12. 10.			KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-02-347-8015 Fax : 82-02-347-8017			
	승인						
재질	검도						도명 SMB-LJ-PC-316 VER.6
	제도						
열처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 CN00857-7/1 K315-152-001		
보호피막처리	적도 1.5/1	단위 mm	종광				